

新华社上海9月17日电（记者高少华）上海华虹（集团）有限公司无锡集成电路研发和制造基地（一期）12英寸生产线17日正式投片，开始55纳米芯片产品制造，标志该项目由工程建设期正式迈入生产运营期。

华虹无锡集成电路研发和制造基地总投资100亿美元，一期项目投资约25亿美元，主要建设一条90-65/55纳米、月产能为4万片的12英寸特色集成电路生产线。

华虹集团党委书记、董事长张素心表示，作为长三角一体化联动沪苏两地的重大产业项目，华虹无锡项目是华虹集团走出上海、布局全国的第一个制造业项目，同时也是无锡市迄今规模最大的单体投资项目。华虹无锡项目建成投产，将成为全国首条12英寸功率器件代工生产线、江苏省第一条自主可控12英寸生产线。

根据规划，华虹无锡集成电路研发和制造基地（一期）生产线项目工艺技术平台覆盖移动通信、物联网、智能家居、人工智能、新能源汽车等新兴应用领域，将进一步满足业界对中高端芯片产品需求。

华虹集团是国家“909”工程的成果与载体，也是我国发展自主可控集成电路产业的先行者和主力军。目前华虹集团在上海和江苏无锡布局了四个制造基地，已经投产3条8英寸、2条12英寸生产线。